

金相切片分析 第三方检测机构-优尔鸿信

产品名称	金相切片分析 第三方检测机构-优尔鸿信
公司名称	优尔鸿信检测技术(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	检测品牌:优尔鸿信 资质:CNAS 检测机构:独立第三方检测机构
公司地址	江苏省昆山市玉山镇南淞路299号B3栋
联系电话	17688164141 18662354467

产品详情

金相切片分析，是从事金属材料研究、开发和质量控制的重要手段之一。通过对金属材料和零部件的显微组织观察和性能分析，可深入了解材料的力学性能、耐腐蚀性能、冶金质量等方面的信息，为产品设计、制造和质量控制提供科学依据。

金相切片分析技术，常用于金属材料和零部件，显微组织观察和性能分析测试。该服务通过制备金相切片，利用光学显微镜，或扫描电子显微镜等设备进行观察和分析，常用于SMT电子元件、PCB/PCBA质量检测、焊点焊接质量、材料开裂、材料缺陷、异物等问题，为客户提供有关金属材料和零部件的质量、性能和可靠性等方面的信息。

金相切片研磨

取样、固封胶、研磨、抛光、微蚀，分析。分析步骤，借助3D显微镜、金相显微镜、SEM扫描电镜等，观察形貌组织，分析金相开裂层的大小、量测目标样品尺寸，结合EDS能谱分析，获得元素成分信息。

通常情况，切片制作，是一项反复的过程，样品包埋，机械研磨完之后，因为材料应力，研磨加工中带入的二次污染，甚至微小加工痕迹，都会影响研磨所需的镜面效果，未必能获得很好的真实样本形貌。如何解决机械研磨的问题，通常会继续采用离子束研磨加工，来完成切片样品的制备。

金相切片检测

金相切片检测，是断面、截面、内部缺陷样本制备的常用试验手段之一，如何分析切片实验样本，桐城借助3D显微镜、金相显微镜、SEM电镜形貌观察，EDS测试,FTIR分析等综合分析技术，助力解决电子元器件、芯片、半导体器件、材料等领域的质量管控难题。

尽管切片分析技术，流程较为成熟，但是需要破坏样本，同时完成不同方向切片，获取目标分析面，对切片工程师来说，不仅需要精湛的切片研磨经验，同时需要具备对不同失效样品的分析测试及问题解决能力。

金相切片分析报告

优尔鸿信，总部富士康华南检测中心，于1996年成立，专业的切片实验室，可提供电子元器件物料筛检、SMT制程工艺优化、PCB/PCBA质量检测、电子产品失效分析等技术服务，提供实验室分析报告，助力电子产品工艺品质管控能力提升。

优尔鸿信金相切片分析技术服务具有以下优势：**专业性强**：该服务由专业的金相实验室提供，具有丰富的金相分析和测试经验。**测试项目全面**：该服务提供的测试项目涵盖了金属材料的各个方面，可满足不同客户的需求。**准确度高**：该服务采用先进的检测设备和仪器，并采用科学的测试方法，确保了测试结果的准确性和可靠性。**定制化服务**：该服务可根据客户的需求提供定制化的测试方案和报告，以满足客户的特定需求。**快速反馈**：该服务提供及时的检测报告和反馈，帮助客户及时发现和解决问题，降低了生产成本和风险。

详情直接咨询 优尔鸿信